

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况和外部环境，以及对公司未来发展的信心和中长期价值认可，制定了《“提质增效重回报”行动方案》。具体如下：

#### 一、聚焦做强主业，提升经营质量

2000年7月，公司在整体变更为股份有限公司时，将“在提高公司经营业绩的同时，为国家集成电路产业发展做出一些贡献”作为企业宗旨，载入《公司章程》。2003年3月，公司作为国内第一家民营芯片设计公司在上海证券交易所挂牌上市。2016年，公司确立了“以国际上先进的IDM厂商为学习标杆，争取早日成为具有自主品牌、具有世界一流竞争力的综合型的半导体产品供应商”这一长期发展目标。

上市20多年来，公司秉持“诚信、忍耐、探索、热情”的企业精神，坚守IDM模式，深耕半导体和集成电路主业，实现了从“5吋”到“12吋”的跨越式发展。公司已在功率半导体、MEMS传感器、模拟电路、光电产品等领域构筑了核心竞争力，已经成为国内最主要的综合型半导体产品公司之一。根据集微咨询发布的2021-2023年《中国半导体企业100强》名单，公司均位列第九名。

最近三年（2021年至2023年），公司始终贯彻“持续提升综合能力，发挥IDM模式的优势，聚焦高端客户和高门槛市场；抓住国内高门槛行业和客户积极导入国产芯片的时间窗口，利用我们有多条不同尺寸硅芯片产线和化合物产线的特点拓展工艺技术与产品平台”这一指导方针，持续在特色工艺平台建设、新技术新产品开发、与战略级大客户合作等方面加大投入，加快产品结构调整的步伐。2023年公司营业收入达到93.40亿元人民币，较2020年的42.81亿元增长118%。

2024年，公司依托 IDM 模式，继续加快推进符合车规级、工业级产品设计、生产、质量、成本、交付要求的体系能力建设，大力拓展大型白电、电动汽车、新能源、算力和通讯、工业等高门槛市场，有力推动了公司主营业务的快速成长。以公司的 IPM 模块、IGBT 产品、SiC 功率器件等产品为例：

（一）公司 IPM 模块自 2012 年开始进入白电、工业市场后，目前已广泛应用于下游家电、工业和汽车客户的变频产品，生产规模及市场占有率位居国内前列。根据《产业在线》公布的统计数据，公司位列“2023 年 IPM 品牌 TOP5 企业”白色家电市场份额第一。2024 年上半年，国内多家主流的白电整机厂商（美的、格力、海尔、海信、奥克斯、长虹等）在变频空调等白电整机上使用了超过 8,300 万只士兰 IPM 模块，较 2023 年同期增加了 56%；公司 IPM 模块的营业收入达到 14.13 亿元人民币，较上年同期增长约 50%。

今年 3 月，国务院公布“两新”行动方案；7 月，国家发展改革委、财政部联合印发支持“两新”的具体举措。截至目前，中央财政支持“两新”的 3000 亿元特别国债资金已全部下达，对拉动投资和拉动消费的“撬动”作用明显。为抓住市场机遇，公司今年已安排了对 12 吋线模拟电路、IGBT 等功率器件芯片产能的扩充、安排了对 IPM 功率模块封装测试生产线产能的扩充，预计 2025 年公司 IPM 产品出货量将继续保持 30% 以上的成长，持续提高在白电、工业、汽车等领域的市场份额，推动公司经营业绩的进一步改善。

（二）公司 IGBT 产品自 2013 年开始应用于家电产品后发展迅速，至 2023 年已实现汽车、光伏、工业、家电等领域的大批量供应，实现了从消费级到汽车级、工业级产品的迭代升级。2023 年，公司 IGBT 的营业收入已达到 14 亿元，较 2022 年同期增长 140% 以上。2024 年上半年，公司 IGBT 和 SiC（模块、器件）的营业收入已达到 7.83 亿元，较去年同期增长 30% 以上。2024 年，基于公司自主研发的 V 代 IGBT 和 FRD 芯片的电动汽车主电机驱动模块，已在比亚迪、吉利、零跑、广汽、汇川、东风、长安等国内外多家客户实现批量供货；用于汽车的 IGBT 器件（单管）、MOSFET 器件（单管）已实现大批量出货；用于光伏的 IGBT 器件（成品）、逆变控制模块、SiC MOS 器件也实现批量出货。同时，公司应用于汽车主驱的 IGBT 和 FRD 芯片已在国内外多家模块封装厂批量销售。2024 年第三季度，公司 8 吋线、12 吋线 IGBT 芯片产能已接近满载，公司已安排技改资金进一步提升 IGBT 芯片产能，预计 2025 年公司在汽车、新能源等市

场的 IGBT 产品的市场份额将大幅度提升。

（三）公司自 2021 年突破并掌握平面栅 SiC 功率器件关键技术，截至目前已完成第 III 代平面栅 SiC MOSFET 技术的开发，性能指标达到业内同类器件结构的先进水平。基于公司自主研发并生产的 II 代 SiC MOSFET 芯片生产的电动汽车主电机驱动模块，已实现向下游汽车用户批量供货，公司成为国内首家采用自主研发的 II 代 SiC 芯片生产汽车主驱用功率模块并批量供货的厂家。目前，基于公司自主研发的 IV 代 SiC MOSFET 芯片即将完成验证，预计 2025 年实现批量供货。2024 年，公司加快推进 6 吋 SiC MOSFET 产能建设，截至目前已具备 9,000 片/月的 6 吋 SiC 芯片生产能力。公司将进一步加大 SiC 芯片生产线的技术改造投入，加快产品技术迭代，进一步提升市场份额。

2024 年 1-9 月，公司实现营业总收入 81.63 亿元，较 2023 年同期增长 18.32%；公司实现归属于母公司股东的净利润 0.29 亿元，较 2023 年同期增加 2.18 亿元。公司已连续 7 个季度实现营业收入的环比增长；今年前三季度，公司电路和器件成品的销售收入中，已有超过 73% 的收入来自大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场，这一数值较 2022 年提高了 3-4 个百分点。公司预计 2024 年全年营业总收入将突破 100 亿元，这将创造中国大陆本土成长起来的半导体 IDM 公司的历史性时刻。

未来，公司将在国家政策的引领下，抓住当前汽车、新能源、算力和通讯等领域快速发展的机遇，充分发挥自身在 IDM 模式下的长期积累以及在功率半导体器件和模块、模拟电路、MEMS 传感器、光电产品等领域的综合竞争优势，进一步推进产品技术迭代和产能结构升级，不断提升产品附加值和产品品牌力，持续推动公司整体营收的较快成长和经营效益的提升。

## 二、持续研发创新投入，加快发展新质生产力

### （一）持续高强度的研发创新投入

公司通过长期高强度的产品和技术研发创新投入，建立了可持续发展的产品和技术研发体系。最近三年（2021 年至 2023 年）公司累计研发投入约 22.53 亿元。近些年来，公司研发、迭代了多类别的新技术产品，主要为多品类的模拟电路，变频控制系统和芯片，MEMS 传感器产品，以第 V 代 IGBT、超结 MOSFET 和高密度沟槽栅 MOSFET 为代表的硅基功率半导体产品，以 1200V SiC MOSFET

为代表的第三代化合物半导体产品；公司完成了多项特色制造工艺技术研究和升级，主要为国内领先的高压 BCD、超薄片槽栅 IGBT、超结高压 MOSFET、高密度沟槽栅 MOSFET、快恢复二极管、MEMS 传感器、SiC MOSFET 器件、GaN 功率器件等。截至 2023 年底，公司共拥有专利 1,171 项，其中发明专利 538 项。

当前，公司研发项目主要围绕先进的车规级和工业级电源管理产品（芯片设计、芯片工艺制造）、车规级和工业级功率半导体器件与模块技术（含化合物 SiC 和 GaN 的芯片设计、制造、封装）、MEMS 传感器产品与工艺技术平台（芯片设计、芯片工艺制造和封装）、车规级和工业级的信号链（接口、逻辑与开关、运放、模数\数模转换等）混合信号处理电路（含芯片设计和芯片制造）、光电系列产品（发光二极管及其它光电器件的芯片制造及封装技术）等五大方面进行。2024 年 1-9 月，公司研发投入 7.55 亿元，同比增长 29.32%，研发投入占营业收入的比重为 9.25%。未来 5 年，公司预计研发投入占营业收入的比重将保持在 8%-10%。公司将持续推动新产品新技术的开发和产业化，不断丰富现有产品群，持续推出高性能、高质量和富有成本竞争力的产品，坚持创新驱动发展，加快培育新质生产力，进一步增强核心竞争能力。

## （二）大力发展第三代半导体产业

近年来，公司大力发展以 SiC、GaN 等化合物产品为主的第三代半导体产业。公司于 2022 年 7 月在厦门制造基地启动了“6 英寸 SiC 功率器件芯片生产线建设项目”，截至目前已具备 9,000 片/月的 6 吋 SiC 芯片生产能力。2024 年年初，公司在杭州基地启动了 8 英寸 GaN 功率器件芯片量产线的建设，截至目前公司 GaN 芯片生产线已实现初步通线，争取尽快推出第一批车规级和工业级的 GaN 功率器件产品。

为进一步完善公司在车规级高端功率半导体领域的战略布局，公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府于 2024 年 5 月 21 日签署了《战略合作框架协议》：各方合作在厦门市海沧区建设一条以 SiC MOSFET 为主要产品的 8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线。该项目分两期建设，项目一期投资规模 70 亿元，规划产能 3.5 万片/月；二期投资规模约 50 亿元，规划产能 2.5 万片/月。两期建设完成后，将形成月产 6 万片 8 英寸 SiC 功率器件芯片的生产能力。目前，公司 8 英寸 SiC 芯片生产线正在加快建设，预计 2025 年年底实现初步通线。

### **（三）完善人才培养和激励机制**

公司建立了较为完善、高效、灵活的人才培养和激励机制，不断加强人才梯队建设，持续完善薪酬体系，拓展员工职业上升通道，为培养和引进高端科技人才创造条件。公司通过制度设计，采用研发奖励、股权激励等方式，鼓励员工创新，支持员工将技术成果申请专利并转化为生产力。公司与国内数家重点高校及科研机构进行产学研合作，成立了博士后科研工作站。2024年6月，公司联合其他单位共同参与的《功率MOS与高压集成芯片关键技术及应用》项目荣获2023年度国家科学技术进步奖二等奖。

目前，公司已拥有一支超过500人的集成电路芯片设计研发队伍、超过3,500人的芯片工艺、封装技术、测试技术研发和产品应用支持队伍。未来，公司将持续完善人才培养和激励机制，持续培养、孵化、吸引更多的人才，为公司发展新质生产力提供强有力的支撑。

## **三、加强投资者沟通，重视投资者回报**

### **（一）持续现金分红，重视投资者回报**

公司高度重视投资者回报，以长期、稳定、可持续发展为基本立足点，基于公司实际经营情况同时兼顾投资者合理回报，综合考虑发展阶段、战略规划和未来资金需求等因素，制定并执行利润分配方案。公司在符合《公司章程》规定的利润分配前提下，优先采用现金分红进行利润分配。2020年至2023年期间，公司累计实施现金分红约3.04亿元。

根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，公司于2024年1月修订了《公司章程》中关于利润分配的相关条款，并于2024年4月披露了《股东分红三年（2024-2026年）回报规划》，进一步规范公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期价值投资理念，积极保障投资者回报的落实。

未来，公司将努力提升经营业绩，为投资者创造长期价值。公司将继续统筹好长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，落实科学、持续、稳定的股东回报机制，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

## **（二）加强投资者沟通，精准传递公司价值**

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切。公司日常通过股东大会、业绩说明会、主题投资者交流活动、投资者关系热线电话及邮箱、上证 e 互动平台、公司官网及微信公众号等多种渠道与投资者进行沟通与交流，及时、准确地向投资者传递生产经营、运营模式、发展战略和企业文化等公司价值信息。公司实现常态化召开投资者说明会，每年召开不少于三次业绩说明会。公司采用图文简报、短视频等可视化形式对定期报告、临时公告进行解读，提高公告的可读性和实用性。

未来，公司将以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，增强信息披露有效性和透明度；进一步加强投资者沟通，提升投资者说明会的质量和效果；不断丰富投资者交流方式和渠道，努力向投资者合规、精准传递公司价值信息，增加投资者对公司价值及经营理念的认同感，提振投资者信心；传递理性投资、价值投资和长期投资理念，保护中小投资者的合法权益，积极维护资本市场健康稳定发展，参与共建良好市场生态。

## **四、坚持规范运作，提升治理水平**

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和要求，并结合股权结构、经营管理、行业发展等实际情况，及时修订《公司章程》等规章制度，构建和持续完善符合公司特色的、科学长效的公司治理机制。公司以股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层为主体，建立了权责清晰、分工明确的法人治理机构与组织架构，依法规范运作，形成互相制衡、有效运行的内部治理机制。

2023 年 12 月和 2024 年 1 月，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，相应修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名与薪酬委员会议事规则》等规章制度。公司将持续落实独立董事制度改革的要求，继续为独立董事履职提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事的监督职能，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会科学决策水平，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东尤其是中小股东的权益。

公司将持续组织实际控制人、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”积极参加合规培训，督促其学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识并及时了解监管动态，不断强化“关键少数”的诚信自律法治意识，确保“关键少数”合规履职，提升公司整体规范运作水平。

## 五、践行 ESG 理念，推进可持续发展

公司始终高度重视环境、社会和公司治理工作，构建了符合自身发展的 ESG 管理架构，将 ESG 融入企业可持续发展战略。公司董事会及下设的战略与投资委员会作为决策层，负责为公司 ESG 愿景、ESG 战略规划、ESG 工作体系构建等工作，回应利益相关方关切。执行层由 ESG 领导小组和工作小组组成，在决策层指导下，统筹协调各部门及子公司推进开展 ESG 相关工作，向董事会战略与投资委员会及董事会提交正式提案，以实现公司 ESG 工作规范推进。

公司已连续 16 年发布社会责任相关报告，并于 2023 年起发布《可持续发展报告》，详细披露公司在环境、社会责任和公司治理等可持续发展方面的实践和绩效。下一步，公司将继续扎实推进 ESG 相关工作，积极履行环境责任、社会责任和公司治理责任，完善 ESG 信息披露制度，提升 ESG 治理水平，赋能公司可持续发展。

“君行吾为发浩歌，鲲鹏击浪从兹始。洞庭湘水涨连天，滕瞳巨舰直东指。”2003 年 3 月 11 日，士兰微作为国内第一家民营芯片设计公司在上海证券交易所挂牌上市。二十多年来，我们经受了多轮行业周期变化所带来的压力和挑战。我们知道：“路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。只要有愚公移山的志气、滴水穿石的毅力，脚踏实地，埋头苦干，积跬步以至千里，就一定能够把宏伟目标变为美好现实。”

当前中国经济正全面走向高质量发展，中国资本市场正在发生重要且深刻的变化。作为中证 300 指数成分股、上证 180 指数成分股，公司将积极贯彻“二十届三中全会”精神，加快培育和发展新质生产力，为实现中国式现代化做出积极贡献！

## 六、其他说明

本公告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能会受到外部经济环境、行业市场环境等因素的影响，具

有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年11月15日